



Tagesordnung

Thema: 61. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **Mittwoch, 11. Oktober 2017, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Aktuelles aus der Gesetzgebung
Herr Dr. Deubzer, Fraunhofer IZM, Berlin
- 3 11:10 Uhr
Kontaktieren, Stapeln, Falten - Montagetechnologien für Mikrosysteme
Herr Dr. Hintz, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt
- 4 11:50 Uhr
Reliability evaluation of Si-dies due to assembly issues
Herr Lorenz, Fraunhofer IMWS, Halle
- 5 12:30 Uhr
Mittagessen

- 6 13:30 Uhr
Zinnwhisker auf Leiterplatten – Konsequenzen für Sicherheitsbauteile
Herr Grommes, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Sankt Augustin
- 7 14:10 Uhr
Hochzuverlässige Leistungsmodule mit BondBuffer® und Cu-Draht
Herr Prof. Osterwald, Danfoss Silicon Power GmbH, Flensburg
- 8 14:50 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
Canary Devices for Through-Silicon Vias
Frau Jerchel, University of Tokyo, Tokyo (JP)
- 10 15:40 Uhr
Werkzeuge für den beschleunigten Entwurf von kompakten Baugruppen in der Mikroelektronik und Leistungselektronik
Herr Stube, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr